

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 8 月 11 日 (11.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/073431 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C23C 18/18, 18/28 (74) 代理人: 酒井 正己, 外 (SAKAI, Masami et al.); 〒1070052 東京都港区赤坂 4 丁目 1 3 番 5 号 赤坂オフィスハイツ Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2004/016764
- (22) 国際出願日: 2004 年 11 月 11 日 (11.11.2004) (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2004-021128 2004 年 1 月 29 日 (29.01.2004) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社日鉱マテリアルズ (NIKKO MATERIALS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1050001 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 河村 寿文 (KAWAMURA, Toshifumi) [JP/JP]; 〒3191535 茨城県北茨城市華川町臼場 1 8 7 番地 4 株式会社日鉱マテリアルズ 磯原工場内 Ibaraki (JP). 鈴木 準 (SUZUKI, Jun) [JP/JP]; 〒3191535 茨城県北茨城市華川町臼場 1 8 7 番地 4 株式会社日鉱マテリアルズ 磯原工場内 Ibaraki (JP). 伊森 徹 (IMORI, Toru) [JP/JP]; 〒3191535 茨城県北茨城市華川町臼場 1 8 7 番地 4 株式会社日鉱マテリアルズ 磯原工場内 Ibaraki (JP).
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PRETREATING AGENT FOR ELECTROLESS PLATING, METHOD OF ELECTROLESS PLATING USING THE SAME AND PRODUCT OF ELECTROLESS PLATING

(54) 発明の名称: 無電解めっき前処理剤、それを用いる無電解めっき方法、及び無電解めっき物

(57) Abstract: A pretreating agent for electroless plating that is soluble in organic solvents and is stable; a method of electroless plating realizing excellent adhesion wherein use is made of the pretreating agent; and a product of electroless plating. Plating object is pretreated with a pretreating agent for electroless plating, comprising a noble metal soap of C₅-C₂₅ fatty acid, preferably further comprising a silane coupling agent with metal trapping capability, such as an imidazole silane coupling agent, and subjected to electroless plating. Palladium soap is preferably used as the noble metal soap.

(57) 要約: 有機溶媒に可溶で、安定な無電解めっき前処理剤、それを使用する密着性に優れた無電解めっき方法及び無電解めっき物を提供することを目的とする。炭素原子数 5 ~ 25 を有する脂肪酸の貴金属石鹸を含む無電解めっき前処理剤、さらに好ましくはこれにイミダゾール系シランカップリング剤などの金属捕捉能を有するシランカップリング剤を含む無電解めっき前処理剤を使用し被めっき物を前処理し、次いで無電解めっきする。貴金属石鹸としては、パラジウム石鹸が好ましい。

WO 2005/073431 A1